

海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司

2024 年度持续督导年度跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：汇成股份
保荐代表人姓名：赵庆辰、何立	被保荐公司代码：688403

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1256 号）批复，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票 16,697.0656 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.88 元，募集资金总额为人民币 148,269.94 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 132,035.96 万元。本次发行证券已于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市。

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]883 号）批复，公司向不特定对象发行 1,148.70 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 114,870.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 114,252.79 万元。本次发行证券已于 2024 年 9 月 2 日在上海证券交易所上市。

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任汇成股份持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 8 月 18 日至 2026 年 12 月 31 日。

在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》

（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2024 年度持续督导情况报告如下：

一、2024 年保荐机构持续督导工作情况

项 目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。
2、根据上市规则规定，与公司就持续督导期间的权利义务签订持续督导协议。	保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。	保荐机构已协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。
4、持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。	保荐机构已持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
5、对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。	保荐机构已对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。
6、督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	保荐机构已督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。
7、上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。	本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。 上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。

项 目	工作内容
上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	
8、督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐机构已督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。
9、持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项，核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。	保荐机构已持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东大会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况。本持续督导期间，上市公司不存在应披露而未披露的重大风险或者重大负面事项。
10、重点关注上市公司是否存在如下事项： （一）存在重大财务造假嫌疑； （二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； （三）可能存在重大违规担保； （四）资金往来或者现金流存在重大异常； （五）上交所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。 出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查，并在现场核查结束后 15 个交易日内披露现场核查报告。	本持续督导期内，上市公司未出现该等事项。
11、关注上市公司股票交易严重异常波动情况，督促上市公司及时按照上市规则履行信息披露义务。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
12、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）主要业务停滞或出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件； （二）资产被查封、扣押或冻结； （三）未能清偿到期债务； （四）实际控制人、董事长、总经理、财务负责人或核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； （五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。

项 目	工作内容
事项： （六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	
13、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化； （二）核心技术人员离职； （三）核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷； （四）主要产品研发失败； （五）核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者； （六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
14、控股股东、实际控制人及其一致行动人出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对上市公司控制权稳定和日常经营的影响、是否存在侵害上市公司利益的情形以及其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）所持上市公司股份被司法冻结； （二）质押上市公司股份比例超过所持股份80%或者被强制平仓的； （三）上交所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
15、督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。	保荐机构已督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。
16、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。	保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议，于 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 27 日及 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 27 日对上市公司募集资金存放与使用情况进行了现场检查。
17、保荐机构发表核查意见情况。	2024 年度，保荐机构发表核查意见具体情况如下： 2024 年 1 月 10 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有

项 目	工作内容
	限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》； 2024年2月1日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》； 2024年4月19日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司开展外汇套期保值交易的核查意见》《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司授信及担保额度预计事项的核查意见》； 2024年4月30日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司2023年度持续督导年度跟踪报告》； 2024年5月16日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司差异化分红事项的核查意见》； 2024年8月9日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》； 2024年8月16日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见》； 2024年8月30日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》及《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见》； 2024年9月3日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司2024年持续督导半年度跟踪报告》。
18、保荐机构发现的问题及整改情况（如有）	无

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

海通证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、技术升级迭代的风险

随着显示面板性能需求的不断提升，显示驱动芯片技术朝着高分辨率、高帧率、高带宽、外围器件较少与功能高度集成化的方向发展。为了满足上述行业发展趋势，显示驱动芯片封测企业需通过设计及工艺的创新不断提升产品性能，为新产品的开发带来了更多的挑战，亦促进了 Bumping、COG 与 COF 等封装技术的发展。

目前公司专注于显示驱动芯片先进封测领域，主要使用 Bumping、COG、COF 等技术。如果未来公司技术升级进度或成果未达预期、未能准确把握行业发展趋势，导致未能成功进行工艺及技术升级迭代，公司市场竞争力将受到不利影响。

2、公司综合技术实力与全球行业龙头相比存在差距的风险

在整个集成电路封测行业，主要公司日月光、Amkor、长电科技、通富微电、华天科技产品线均横跨封测行业多个细分领域。在显示驱动芯片封测领域，头部企业硕邦科技、南茂科技依托原有技术布局其他细分领域多年，积极开拓新的产品线。公司在封测行业其他细分领域的研发能力与技术实力仍处于积累阶段，与行业头部公司存在一定差距。

在未来,如果公司未能实现其他细分领域封装工艺的研发,弥补与行业头部公司在研发能力与技术实力方面的差距,将对公司业务拓展、收入增长和持续经营带来不利影响。

3、核心技术人才流失的风险

公司所处集成电路封测行业为典型的技术密集型行业,面临核心技术人才流失或不足、技术泄密等高科技企业共同面临的技术风险。

显示驱动芯片封测行业对技术人员专业程度、经验水平均有较高要求。目前中国大陆显示驱动芯片封测行业人才缺口较大,行业内人才争夺较为激烈、人员流动较为频繁。若公司核心技术人才流失或无法继续培养或招揽,将对公司的研发生产造成较大不利影响。

(二) 经营风险

1、市场竞争加剧的风险

报告期内,随着厦门通富微电子有限公司、昆山日月同芯半导体有限公司、广西华芯振邦半导体有限公司等行业新进入者产能释放,显示驱动芯片封装测试领域竞争逐渐激烈。相比于集成电路封测行业头部企业,公司业务规模和综合竞争力存在较大差距,应对行业内规模竞争和价格竞争的能力仍然不足。随着行业竞争态势愈发激烈,市场竞争加剧的风险可能使公司的业务受到一定冲击,若公司不能较好地采取措施应对,可能会对公司业务开拓以及未来经营业绩产生不利影响。

2、客户集中度较高的风险

报告期内,公司对前五大客户的销售额合计为 99,625.96 万元,占年度销售总额的比例为 66.37%,同比下降 6.23 个百分点,但客户集中度较高的问题依旧存在。如果未来公司的主要客户市场份额出现下滑,导致其向公司下达的订单数量下降,或公司无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新的客户资源,将可能对公司经营业绩产生不利影响。

3、供应商集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大供应商采购额合计为 76,108.94 万元，占年度采购总额的比例为 61.07%，供应商集中度较高。如果公司主要供应商生产经营发生重大变化，或交付能力未能满足公司要求，或与公司业务关系发生变化，公司在短期内可能面临关键设备和原材料短缺，从而对公司的生产经营产生不利影响。

4、其他芯片封测细分领域客户开拓结果不及预期的风险

公司投入大量资金持续建设研发中心、吸纳技术人才，研发凸块制造技术及车规级芯片、存储芯片等其他细分领域封装技术。如果公司未来在其他芯片封测细分领域客户开拓结果不及预期，有可能影响未来的业绩增长空间。

（三）财务风险

1、毛利率波动及下滑的风险

报告期内，公司主营业务毛利率为 22.34%，同比下降 4.83 个百分点，主要系可转债募投项目扩产导致报告期内新增设备折旧摊提等固定成本提高，同时设备折旧摊提进度阶段性领先于实际产能爬坡进度，产能利用率略低于上年同期水平，导致毛利率同比有所下降。如果未来受显示面板产业周期波动影响，或国家产业政策调整，导致显示驱动芯片封测需求持续下滑，公司可能无法获取充足的客户订单形成生产规模效应，以及公司生产及管理能力和水平若无法适应未来发展，造成营业成本过高，将使得公司封测服务的单位成本处于较高水平；或者行业新进入者和新扩产能增加，竞争加剧促使显示驱动芯片封装测试业务价格下降，均可能导致公司毛利率面临进一步下滑的风险。

2、存货跌价风险

报告期末，公司存货账面价值 28,834.30 万元，占期末流动资产的比例为 17.91%。公司期末存货金额较大，占比较高，并且公司存货金额可能随着公司业务规模扩大进一步增长，占用公司较多的经营资金。如果未来市场需求、价格发生不利变动，可能导致公司存货积压、跌价，公司营运资金压力增加，从而对公司经营业绩造成不利影响。

3、新增固定资产折旧规模较大风险

公司所处集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，要形成规模化生产，需要进行大规模的固定资产投资。报告期内，公司市场开拓良好，为了应对持续增长的市场需求，公司通过自筹资金及可转债募集资金持续加大投资力度，固定资产规模持续增加，对应所产生的折旧费用保持在较高水平，报告期内固定资产折旧费用金额为 36,211.89 万元，较上年约增加 8,480.32 万元。公司新增固定资产折旧规模较大，期末在建工程的逐步转固会进一步增加固定资产的折旧规模，新增固定资产折旧将可能对公司的经营业绩产生较大的影响。如果公司未来市场及客户开发不利，不能获得与新增折旧规模相匹配的销售规模增长，则公司存在因新增固定资产折旧规模较大导致利润下滑的风险。

4、汇率波动风险

公司的记账本位币为人民币，公司对境外客户（以直接客户注册所在地为统计口径）销售金额占主营业务收入的比例接近 60%左右，境外销售及采购主要交易采用美元、日元等外币计价。报告期内，受汇率波动的影响，公司汇兑收益为 658.78 万元。如果未来境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得外币汇率大幅波动，公司有可能面临汇兑损失的风险。

（四）行业风险

公司所封装测试的芯片广泛应用于智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴等各类终端消费产品。受全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，上述终端产品消费存在一定周期性，若下游终端市场需求大幅减少，将对产业链上游供应产生不利影响，若公司无法提高市场占有率，提升对客户的供应份额，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

（五）宏观环境风险

1、区域贸易政策变化导致的风险

集成电路封装测试行业对原材料和设备有较高要求，公司报告期内主要生产设备和部分原材料均采购自中国境外（以日本为主，具体以设备与原材料原产地为统计口径）；同时，公司的主要客户亦为境外企业（以中国台湾地区为主）。如果未来相关国家或地区与中国的区域贸易政策发生重大变化，限制进出口或提高

关税，公司可能面临生产设备、原材料短缺和客户流失等情形，进而导致公司生产受限、订单减少、单位成本增加，对公司的业务和经营产生不利影响。

2、产业政策变化的风险

集成电路产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业。近年来，国家出台了包括《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》等在内的一系列政策，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面为集成电路企业提供了更多的支持，以推动集成电路行业发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力。如果未来国家相关产业政策出现重大不利变化，将对公司发展产生一定不利影响。

四、重大违规事项

2024 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	本期比上年同期 增减（%）	2022 年
营业收入	150,101.97	123,829.30	21.22	93,965.28
归属于上市公司股东的净利润	15,976.42	19,598.50	-18.48	17,722.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,400.39	16,819.47	-20.33	12,618.17
经营活动产生的现金流量净额	50,086.38	35,145.96	42.51	60,114.17
项目	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2022 年末
归属于上市公司股东的净资产	320,107.09	313,203.07	2.20	290,370.59
总资产	459,122.37	359,629.70	27.67	319,563.25

（二）主要财务指标

项目	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)	2022 年
基本每股收益（元 / 股）	0.19	0.23	-17.39	0.24
稀释每股收益（元 / 股）	0.19	0.23	-17.39	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.16	0.20	-20.00	0.17
加权平均净资产收益率（%）	5.12	6.49	下降 1.37 个百分点	9.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.30	5.57	下降 1.27 个百分点	6.54
研发投入占营业收入的比例（%）	5.96	6.37	下降 0.41 个百分点	6.93

2024 年度，受益于下游需求企稳及可转债募投项目新扩产能逐步释放，公司出货量持续增长，营业收入同比增长 21.22%，达 150,101.97 万元。

2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 15,976.42 万元，同比下降 18.48%，主要影响因素包括以下几个方面：（1）可转债募投项目扩产导致报告期内新增设备折旧摊提等固定成本提高，同时设备折旧摊提进度阶段性领先于实际产能爬坡进度，产能利用率略低于上年同期水平，致使主营业务毛利率同比下降 4.83 个百分点，下滑至 22.34%；（2）显示驱动芯片产业转移效应持续深化，境内外细分领域封测厂商竞争加剧，封测业务价格有所下滑；（3）报告期内，公司使用自筹资金先行投资可转债募投项目，借款利息有所增加，且可转债发行完成后因计提利息进一步增加财务费用，对公司盈利水平造成一定影响。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 42.51%，主要系随着公司可转债募投项目的实施，新扩产能逐步释放，客户订单持续导入，营收规模增加，销售商品收到的现金增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）领先的技术研发优势

显示驱动芯片封测行业属于技术密集型行业，公司所应用的封测技术均属于高端先进封装形式。公司拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒。

公司所掌握的凸块制造技术（Bumping）是高端先进封装的代表性技术之一，通过凸块制造“以点代线”的技术创新，以几何倍数提高了单颗芯片引脚数的物理上限，进而大幅提高了芯片封装的集成度、缩小了模组体积。公司封装工艺中的玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）均使用高密度、细间距的倒装凸点互连芯片封装技术。上述工艺基于前沿的倒装芯片（FC）封装技术，结合自身生产工艺与设备进行优化，所封测的产品拥有 I/O 密度高、尺寸小、运算速度快、可靠性高和经济性佳等优势。

（二）知名客户的资源优势

显示驱动芯片的封装测试厂商需要经过芯片设计公司较长时间的工艺认可，而后才能达成长期合作意向，故存在较高的供应链门槛。凭借稳定的封测良率、灵活的封装设计实现性、生产一体化、不断提升的产能规模、交付及时性等，公司获得了行业内知名客户的广泛认可，已经建立了较强的资源优势。

公司与联咏科技、天钰科技、集创北方、奕力科技、瑞鼎科技、奇景光电、新相微、爱协生、云英谷等行业内知名芯片设计公司建立了稳定的合作关系，并曾获得联咏科技颁发的“最佳配合供应商奖”和“最佳品质供应商奖”，公司所封测芯片已主要应用于京东方、维信诺、友达光电等知名厂商的面板，深厚的客户资源为公司的长期发展带来源源动力。

（三）专业的管理团队优势

公司拥有专业的管理团队，部分核心管理成员曾供职于显示驱动芯片封装测试领域的龙头企业，具备超过 15 年的技术研发或管理经验，具备行业内领先企业的发展视野。公司管理团队对于整个行业的发展以及公司的定位有着较为深刻的认识，是一支经验丰富、结构合理、优势互补的核心团队，为持续提升公司核心竞争力和开发新工艺提供了强有力的人力资源支持。

封测行业客户需求较为多样化，不同的产品需求往往需要不同的生产工艺、技术及管理队伍相匹配，这对封测企业的生产组织能力和质量管理提出了严格的要求。在公司专业管理团队的带领下，公司致力于持续提升生产管理水平、强化质量管理，已具备业内领先的产品品质管控能力，所封装产品具有集成度高、稳

定性强、体积轻薄等客户需求的品质，产品良率高达 99.90%以上，得到行业客户的高度认可。

（四）持续扩大的规模优势

显示驱动芯片设计公司选择长期合作伙伴时，着重考虑封装测试厂商是否具备足够的产能规模，是否具备大批量、高品质供货的能力。随着公司首次公开发行股票募投项目已于 2023 年结项、公开发行可转换公司债券募投项目快速实施，报告期内公司产能显著提升，出货规模持续扩大。同时，公司仍在持续购置先进生产设备进行产能扩充，将继续利用规模优势来巩固和提高在全球行业内的竞争地位。

（五）完善的管理体系优势

公司高度重视产品质量的管控，将产品质量视为企业生存和发展的核心。公司一直致力于建立健全质量管理体系，通过了包括 IATF 16949:2016 在内的一系列国际体系认证，拥有完善的质量管理体系，这也是公司能够获得众多知名客户长期信赖的基石之一。

报告期内，公司及全资子公司江苏汇成经过严格审核已通过了汽车行业质量管理体系 IATF 16949:2016 正式认证，并取得注册证书。表明公司在显示驱动芯片封装测试服务领域全面符合 IATF 16949:2016 质量管理体系的要求，在产品质量管理、持续改进及客户满意度方面达到了国际汽车行业的高标准要求，也标志着公司在车载显示领域取得了进入国内外汽车行业供应链的准入通行证。

（六）全流程统包生产优势

公司在显示驱动芯片封装测试领域具有领先地位，是中国大陆少数同时拥有 8 吋和 12 吋产线的显示驱动芯片全流程封测企业，业务覆盖了金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装完整四段工艺制程，是全球少数可以实现显示驱动芯片封装测试服务一体化的企业。公司提供的全流程服务有效提高了生产效率、缩短了交付周期、降低了生产成本，并且避免了晶圆测试与封装流程中间长距离周转而导致晶圆被污染的风险。

（七）地理与产业集群优势

公司位于中国集成电路产业中心城市合肥，合肥系“一带一路”和长江经济带战略双节点城市，也是长三角区域经济一体化重要城市。合肥市具有良好的产业基础和经营环境，政府大力推进集成电路产业的集群发展。此外，长三角地区是我国集成电路产业集中度最高、产业链最完整、制造水平最高的区域，具有较为显著的范围经济效益，公司立足长三角有利于更贴近客户和原辅材料供应商，产生协同作用。

公司总部位于合肥市综合保税区，目前合肥的集成电路产业已初具规模，产业链上下游从芯片设计、晶圆制造、封装测试到配套材料设备或产成品应用等方面的企业已相对完整，公司上下游企业如晶合集成、京东方、维信诺等均落户合肥或建厂，因而公司深入产业集群之中，可以有效节省运输时间与成本，提高生产响应速度以加快产品交付，缩短供应链周期，有利于享受集成电路产业集群红利。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

公司投入大量资金持续建设研发中心、吸纳技术人才，研发凸块制造技术及车规级芯片、存储芯片等其他细分领域封装技术。本报告期研发投入 8,940.69 万元，较上年同期增长 13.38%。

未来，公司将不断提升先进封装技术水平，学习引进不同的封装工艺、优化并提高现有工艺的流程与效率；积极扩充 12 吋晶圆的先进封装测试服务能力，保持行业及产品的领先地位，同时将进行持续的研发投入，不断拓宽封测服务的产品应用领域，积极拓展以车规芯片、存储芯片等更多细分领域；加强市场开拓和品牌建设，夯实领先的成本管控和质量管理优势；逐步实现集成电路先进封装测试领域的进口替代，提高中国大陆集成电路先进封装测试行业的自主产研水平。

报告期内，公司新获发明专利 18 项、实用新型专利 63 项。截至报告期末，公司累计获得发明专利 47 项、实用新型专利 442 项、软件著作权 3 项。

单位：万元

项目	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	8,940.69	7,885.72	13.38
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	8,940.69	7,885.72	13.38
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.96	6.37	减少 0.41 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

（二）研发进展

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	一种载盘固定校正机构设计	800.00	166.77	877.67	导入量产	降低翻盘次数，提升固定杆稳定性.提升晶粒转置良率	国内领先	高阶显示驱动芯片、CMOS 影像传感器芯片和新能源车载芯片等领域
2	一种高温测试环境的快速降温设计	750.00	350.10	790.60	导入量产	提升测试环境温度稳定性，能快速达到降温目的	国内领先	显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
3	高深宽比线路金凸块生长工艺的研发	800.00	450.42	894.95	项目结案	解决了现有金凸块制造工艺制备出来的金凸块在高深宽比线路区中间产生空洞无法填充完整的问题。	国内领先	显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
4	高解析密集驱动封装技术研发	800.00	708.50	846.97	导入量产	高密度金凸块生产工艺技术,越高的驱动芯片控制与分辨率能力考验生产稳定度,稳定生产良率	国内领先	显示驱动芯片等领域
5	先进封装领域一种黏轮机构工艺研发	800.00	365.55	783.11	导入量产	导入黏轮机构至生产工艺内，降低 particle 影响并提升产品良率	国内领先	高阶显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
6	凹型金凸块工艺研发	800.00	741.75	869.61	导入量产	提升 ACF 中导电粒子捕获数	国内领先	显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
7	先进封装领域一种测试分类机传送机构工艺研发	800.00	747.86	792.67	导入量产	通过设计新式传送机构，提升产品传送稳定度及品质，使产品大幅降低芯片崩缺/隐裂风险及强化抗静电能力	国内领先	高阶显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
8	晶圆减薄化表面应力提升技术研发	800.00	729.68	729.68	小批量生产	改变研磨工艺的进给速率与颗粒度调整，使产品大幅降低芯片断裂风险及强化抗弯折能力	国内领先	高阶显示驱动芯片、车载芯片等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
9	一种半导体测试设备专用致冷芯片快速变温的装置	800.00	418.19	418.19	样品试制	在 chuck 上快速的降温	国内领先	显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
10	一种半导体涂布设备专用前置定位校正装置	800.00	483.69	483.69	小批量生产	设计新式注胶工艺,达到提高产品品质、增加机构使用寿命;减少异常发生维护产品耗时,提升工作效率	国内领先	显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
11	先进封装领域一种新型注胶工艺研发	800.00	473.60	473.60	样品试制	设计新式注胶工艺,达到提高产品品质、增加机构使用寿命;减少异常发生维护产品耗时,提升工作效率	国内领先	显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
12	复合型铜镍金凸块工艺研发	800.00	249.01	249.01	样品试制	研发新型复合型铜镍金凸块取代金凸块制程取得价格的优势	国内领先	显示驱动芯片、电源管理芯片
13	一种自动拍照比对 IC 规格装置	800.00	189.38	189.38	工艺设计与开发	通过设备取代人工检验作业,并比对出晶粒微米级差异,有效将产品不良防堵在厂内而不出货,质量保证	国内领先	所有 Tray 装晶粒均可应用
14	先进封装领域一种提升制程洁净度的研发	800.00	83.49	83.49	工艺设计与开发	设计制程洁净度装置,达到提高机台空气质量,减少机台外部环境影响;提高产品质量和生产效率	国内领先	显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
15	多段式光阻去除工艺的研发	500.00	134.14	471.69	导入量产	降低产品异常发生率,提高产品品质及良率	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
16	柔性基板(FILM)双芯封装技术的研发与应用	600.00	320.89	596.90	导入量产	提升芯片集成度,扩展芯片功能及品质稳定性	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
17	一种减少负胶蚀刻气泡异常的结构及工艺研发	600.00	449.39	505.45	导入量产	减少蚀刻药液气泡产生,提升蚀刻效果,降低蚀刻异常发生率,提升产品品质及良率	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
18	显示驱动封装磨划技术工艺的研发与应用	600.00	422.21	587.07	导入量产	解决产品破损问题，提升产品可靠性与良率	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
19	高精度晶圆溅镀定位技术的研发与优化	500.00	274.58	274.58	样品试制	降低晶圆在溅镀工艺中的定位偏差，提高产品品质及良率	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
20	显示驱动封装自动检验IC 技术工艺研发与应用	600.00	622.02	622.02	小批量生产	提升产品品质检验能力	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
21	柔性基板封装工艺中载具自动识别技术的研发	600.00	511.36	511.36	样品试制	扩充柔性基板封装工艺产品种类的多样化	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
22	钯金属替代金凸块在集成电路封装中的应用研究	1,000.00	48.11	48.11	工艺设计与研发	金属钯替代部分金属金，提高封装效率，降低生产成本，提升产业竞争力	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
合计	/	16,150.00	8,940.69	12,099.80	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人首次公开发行股票并上市的募集资金已使用完毕。

截至 2024 年 12 月 31 日，发行人向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	114,252.79
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	105,958.26
	利息收入净额	C2	68.86
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	105,958.26
	利息收入净额	D2=B2+C2	68.86
应结余募集资金		E=A-D1+D2	8,363.39
实际结余募集资金 ^注		F	8,363.39
差异		G=E-F	-

注：其中公司募集资金专户存放的活期存款余额 3,363.39 万元，理财余额（含结构性存款）5,000.00 万元，部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反

洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 12 月 31 日，汇成股份控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

十二、其他说明

本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司
2024 年度持续督导年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



赵庆辰



何立

